

臭化タリウムによる直接変換 X 線イメージングセンサ技術







モー ハムダン^{*1} Moh Hamdan

1 はじめに

X線イメージングセンサ技術は、産業用途では異 物検査や内部構造の検査等広範囲で利用され、医療 用途ではレントゲンによる肺の検査やマンモグラ フィー、CT (computed tomography) また他の複数 の科学目的でも必要とされる必須の技術である。特 に、近年は従来の IP (imaging plate) に加えてリア ルタイムに画像化が可能なデジタルラジオグラフィ が主流となりつつある。このようなデジタルラジオ グラフィシステムでは FPD(flat panel detector フラッ トパネル検出器) が重要な役割を果たしている。

X線FPDにおいては、一般にシンチレータでX線 を光に変換した後に光センサで電荷量を計測する間 接変換方式とX線を直接的に電子正孔対に変換す る直接変換方式が存在する。信号の読出は大型イ メージングセンサ実現のため、大型化が可能なディ スプレイ技術の1つであるTFT (thin film transistor) を利用した電荷の蓄積とスイッチング読出により実



図 1 間接変換(indirect)と直接変換(direct)方式の Flat panel detector (FPD)



野上 光博^{*2} Nogami Mitsuhiro



人見啓太朗^{*2} Hitomi Keitaro

現されている (図1)。

これまで、X線を可視光領域の光に変換するシン チレータとピクセル型のフォトダイオードマトリッ クスを組み合わせた間接変換型の FPD が多く開発 され、利用されてきた。

このような検出器では高分解能や低被ばくを実現 可能な CsI(ヨウ化セシウム)やより低価格・高密 度な GOS(酸硫化カドリニウム)セラミック等が 用いられることが多く,それぞれ広く使われている。

直接変換型の FPD としては融点が 221 ℃と低く, 大面積化が可能な a-Se (アモルファスセレン)を用 いた開発が行われている。直接変換型のメリットと しては一般的に,間接変換型のような光広がりが少 なく,高解像度化が可能とされている。一方で,よ り電子正孔対エネルギー (ε 値)が小さく高感度化 が可能な CdTe (テルル化カドミウム)を用いたシ リコン半導体集積回路と組み合わせたピクセルセン サの開発も進んでいる¹⁾が,CdTe は 1041 ℃と高 融点のため,バンプ接合が必要であり大型化や低コ スト化に大きな課題がある。

このような背景から,筆者らの研究開発グループ ではTIBr(臭化タリウム)に着目し,高解像度化, 高感度化,大面積化が原理的に可能な直接変換型 X線イメージングセンサの開発を実施してきた。そ の概要について次章から紹介する。

2 X線イメージングセンサ

臭化タリウムは臭素(Br Z=35)とタリウム(TI Z=81)から成る,化合物半導体結晶である。高い 密度(7.56 g/cm³)であり,これまで特にγ線スペ クトロスコピー用途で開発されてきており²⁾,室温 において 622 keV のγ線に対し半値幅が1%程度の 良好なエネルギー分解能を有することが確認されて いる。また近年,チェレンコフ光を用いた時間分解 にも利用可能なこと³⁾が示され,時間分解能,エ ネルギー分解能の両方に優れた素子としても注目さ れている。

X線 FPD で用いられている各素子の大まかな比較を表1に示す。臭化タリウムが高い密度(~高い

	密度 g/cc	発光量 ph/keV	ε值 eV	融点 ℃
CsI	4.53	64	-	-
GOS	7.34	55 (半透明) -		-
a-Se	4.3	-	- 50	
CdTe	5.85	- 4.43		1041
TlBr	7.56	-	5.5	460

表1 X線イメージングセンサ各素材の比較



図2 直接変換材料の減衰係数比較

表 2 FPD に用いられる TFT 技術

	a-Si	LTPS	IGZO
電子移動度	-1cm ² /Vs	$> 100 \mathrm{cm}^2/\mathrm{Vs}$	-25cm ² /Vs
リーク電流	高	低	極低
コスト	低	高	中

X線変換効率)と小さい電子正孔対生成エネルギー (ε値~高い信号雑音比),低融点(460℃~大面積 化)と良好な性質を有していることが分かる。

一般に,間接変換型は既知の発光量 (photon/keV) からシリコンの ε 値 3.6 eV で除算した値が記録され うる最大信号電荷量となるため,直接変換型の値と 比較すると 1 桁以上信号生成量が少ないことが分か る。すなわち直接変換材料は信号が大きく信号雑音 比の高いセンサを作ることに適していると言える。

また,直接変換材料の光子エネルギーに対する線 減衰係数の比較を図2に示す。大面積化が可能な a-Seと比較して臭化タリウムは高い減衰係数を有し ており,CdTeと比較しても高エネルギー領域で高 い感度を有することが確認できる。

信号処理部分のトランジスタである TFT には a-Si (アモルファスシリコン),ポリシリコン, IGZO (indium gallium zinc oxide)等が用いられる(表 2)。 ここでは詳細には触れないが,本研究では JDI(Japan Display)社の協力を得て,移動度の高い低温ポリ シリコン(LTPS)技術を用いたフラットパネル検 出器読出フロントエンド回路を用いた。

3 臭化タリウム X 線イメージングセンサ

本研究では、原理検証としてピクセルサイズ 235 µm×235 µmの 126×168 ピクセルで構成される 29.61 mm×39.48 mm サイズの LTPS TFT 技術で作 成されたフラットパネルを用いた。パネルの直接変 換膜とのコンタクト電極は 10 nm 厚の ITO (indium tin oxide) で構成している。本フラットパネル上に、 東北大学で精製・作成された臭化タリウム結晶をも とに、400~500 ℃で真空蒸着により 50 µm 程度ま での蒸着膜を形成した。その後に上部電極として金 を蒸着し、臭化タリウム変換膜を有する X 線フラッ トパネル検出器を作成した。図3に開発したX線 イメージングセンサの外観を示す。上部のパネルか らの読み出しは FPC (Flexible Printed Circuit) によ り AFE (Analog Front End) 回路に伝送され, 最終 的に FPGA (Field Programmable Gate Array) で構成 した DAQ (Data Acquisition) システムにより画像 化する。上部の金電極と GND 間に電圧を印加する ことで動作を行う。



図 3 開発した臭化タリウム直接変換 X 線イメージン グセンサ



図4 臭化タリウム膜の抵抗値測定体系

4 臭化タリウム X 線イメージングセンサの性能

まず、 $12 \times 12 \text{ mm}^2$ のエリアに 53 μm の厚みで蒸着した臭化タリウム膜の抵抗値を測定した。 $0 \sim 4 \text{ V}$ 程度の間でほぼ線形応答を示しており抵抗値 $1.02 \times 10^8 \Omega$ 、抵抗率 $2.78 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ が得られた。**図4** に蒸着膜の写真を示している。

次にピクセル型の臭化タリウム X 線イメージン グセンサの空間分解能評価を行った。

図5に Slated Edge 法を用いた空間分解能評価結



図 5 空間分解能評価(25 µm, 50 µm 厚)





果を示す。X 線発生管の管電圧 / 電流 30 kV/2 mA において、半値幅(FWHM: full width at half maximum) として、25 μ m 厚センサで 260 μ m、50 μ m 厚センサ で 277 μ m の解像度が得られた。ピクセルサイズが 235 μ m であることを考えると妥当な値である。

また、25 μ m と 50 μ m でのセンサ応答の管電圧依 存性を図6に示す。25 μ m では 80 kV 程度でピクセ ル値の飽和が見られるが、50 μ m では飽和が見られ ず、高エネルギーX 線についても感度を有している ことが確認できる。

図7に、小型ニボシの臭化タリウムイメージング センサを用いた撮像例を示す。50µm厚の臭化タリ ウム膜,23kV/0.25 mAの条件で撮像した。骨の細 かい形状まで取得できていることが分かり、均一な 画像が得られることが確認できた。

5 まとめと将来展望

本研究では、東京大学、東北大学、JDIの協力に より臭化タリウム膜のX線イメージングセンサへ の形成技術の確立と撮像性能の検証⁴⁾を行った。 50 µm 厚までの臭化タリウムを蒸着したX線イメー ジングセンサの開発に成功し、期待される空間解像 度が得られている。今後の課題としてより高感度化



図7 小型ニボシの撮像例(23 kV/0.25 mA)

のため 100 μm 厚程度までの厚膜化やフラットパネ ル検出器の低ノイズ化により,更に高い信号雑音比 を有し,低線量撮像を可能にする FPD の研究開発 を進める。また,臭化タリウムの蒸着は,大面積化 への適用が比較的容易であり,同様にメートルサイ ズまで大型化が可能なフラットパネル技術との相性 がよい。超大型 CT 等の開発への応用も期待される。 加えて,従来型のフラットなパネルだけでなく,曲 面等のこれまでにない形状を作成可能である点も見 逃せない。特殊形状を用いた生体応用等も期待され る。また LTPS や IGZO 等の TFT 技術は電子移動度 の改善と共に信号処理技術としても可能性⁵⁾を秘 めており,単なる電荷蓄積型センサ以外への応用に も期待ができる。

参 考 文 献

- Ballabriga, Rafael, et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 878, 10-23 (2018)
- Hitomi, Keitaro, et al., Journal of Crystal Growth, 379, 93-98 (2013)
- Hamdan, M., et al., Journal of Instrumentation, 19, 11, C11017 (2024)
- Hamdan, Moh, et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 1064, 169372 (2024)
- 5) Shimazoe, K., et al., Journal of Instrumentation 12,02 C02045 (2017)

(*1東京大学, *2東北大学)